

FEATURES

砥石の中から研削液供給実現！

GaN/Al₂O₃ 専用高脆材研削用砥石

エッジチッピングの大幅低減

集中度180 研削効率大幅U

ビトリファイドボンディング

ポア効果による目詰まり解消

ポーラスセラミックス砥石

砥石の磨耗が少ない高寿命

Grinding Diamond Wheel for GaN/Al₂O₃ Wafer



CEG-200-250X-PO



SD-325P-160-VP

高脆性材料GaN/Al₂O₃ウェーハ用研削砥石

研削液を砥石の中から滴入し被削材に十分な研削液の供給を実現しました。

従来から課題でありました研削液の供給を砥石の中から滴入することにより研削スピードの効率化と目詰まり防止効果を高めました。

温度変化による研削性能のバラツキや、砥石の局部温度上昇による早期炭化を防ぎ安定した研削加工を実現いたします。

■GEP-3Xでの研削条件

	CEG-200-250X-PO	SD-325P-160-VP
研削加工条件	ポーラスタイプ #230/270	プローブタイプ #230/270
砥石径	Φ450mm	φ450mm
砥石研削速度	20 μ/min	10 μ/min
砥石回転数	1800rpm	1000rpm
ウェーハテーブル回転数	100rpm	80rpm
研削量	500 μm	100 μm

極薄GaN/Al₂O₃ウェーハ用に新たに開発されたEG200-250X-POとSD-325P-160-VPはダイヤモンドの集中度が他社製品80~120に対し集中度180と非常に高く、高密度性を保ち、細粒発泡技術を実現し砥石の目溜まりを低減させ、脅威の研削効率を発揮します。他に類のない画期的なポーラスセラミックビトリファイド砥石とプローブタイプの2種類を研削条件に合わせてご使用下さい。